

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2026年度银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2026年度预计向银行申请授信额度的情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额不超过60,000.00万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议审议情况

2026年1月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

董事会

2026年1月19日